1．空焊——零件脚或引线脚与锡垫间没有锡或其它因素造成没有接合。

2．[假焊](http://www.haosou.com/s?q=%E5%81%87%E7%84%8A&ie=utf-8&src=wenda_link)——假焊之现象与空焊类似，但其锡垫之锡量太少，低于接合面标准。

3．[冷焊](http://www.haosou.com/s?q=%E5%86%B7%E7%84%8A&ie=utf-8&src=wenda_link)——锡或锡膏在回风炉气化后，在锡垫上仍有模糊的粒状附着物。

4．[桥接](http://www.haosou.com/s?q=%E6%A1%A5%E6%8E%A5&ie=utf-8&src=wenda_link)——有脚零件在脚与脚之间被多余之焊锡所联接短路，另一种现象则因检验人员使用镊子、竹 签…等操作不当而导致脚与脚碰触短路，亦或刮CHIPS脚造成残余[锡渣](http://www.haosou.com/s?q=%E9%94%A1%E6%B8%A3&ie=utf-8&src=wenda_link)使脚与脚短路。

5．错件——零件放置之规格或种类与作业规定或BOM、ECN不符者，即为错件。

6．缺件（少件）——应放置零件之位址，因不正常之缘故而产生空缺。

7．极性反向——极性方位正确性与加工工程样品装配不一样，即为极性错误。

8．零件倒置——SMT之零件不得倒置，另CR因底部全白无规格标示，虽无极性也不可倾倒放置。

9．零件偏位——SMT所有之零件表面接着焊接点与PAD位偏移不可超过1/2面积。

10．锡垫损伤——锡垫（PAD）在正常制程中，经过回风炉气化熔接时，不能损伤锡垫，一般锡垫损伤 之原因，为修补时使用烙铁不当导致锡垫被破坏，轻者可修复正常出货，严重者列 入次级品判定，亦或移植报废。

11．污染不洁——SMT加工作业不良，造成板面不洁或CHIPS脚与脚之间附有异物，或CHIPS修补不 良、有点胶、防焊点沾漆均视为不合格品。但修补品可视情形列入次级品判定。

12．SMT爆板——[PCB](http://www.haosou.com/s?q=PC%E6%9D%BF&ie=utf-8&src=wenda_link)在经过回风炉高温时，因板子本身材质不良或回风炉之温度异常，造成板子离 层起泡或白斑现象属不良品。

13．包焊——焊点焊锡过多，看不到零件脚或其轮廓者。

14．锡球、锡渣——PCB板表面附着多余的焊锡球、锡渣，一律拒收。

15．异物——残脚、铁屑、钉书针等粘附板面上或卡在零件脚间，一律拒收。

16．污染——严重之不洁，如零件焊锡污染氧化，板面残余[松香](http://www.haosou.com/s?q=%E6%9D%BE%E9%A6%99&ie=utf-8&src=wenda_link)未清除，清洗不注意使CHIPS污染氧 化及清洗不洁（例如SLOT槽不洁，SIMM不洁，板面CHIP或SLOT旁不洁，SLOT内侧上 附有许多微小锡粒，PC板表面水纹…等）现象，则不予允收。

17．跷皮——与零件脚相关之接垫不得有超过10%以上之裂隙，无关之接垫与铜箔线路不得有超过25% 以上之裂隙。

18．板弯变形——板子弯曲变形超过板子对角长度0.5%以上者，则判定拒收。

19．撞角、板伤——不正常缘故产生之板子损伤，若修复良好可以合格品允收，否则列入次级品判定。

20．DIP爆板——PC板在经过DIP高温时，因PC板本身材质不良或锡炉焊点温度过高，造成PC板离 层起泡或白斑现象则属不良品。

21．跪脚——CACHERAM、K/BB10S…等零件PIN打折形成跪脚。

22．浮件——零件依规定须插到底（平贴）或定位孔，浮件判定标准为SLOT、SIMM浮高不得超过0.5mm， 传统零件以不超过1.59mm为宜。

23．刮伤——注意PC板堆积防护不当或重工防护不当产生刮伤问题。

24．PC板异色——因[回流焊](http://www.haosou.com/s?q=%E5%9B%9E%E6%B5%81%E7%84%8A&ie=utf-8&src=wenda_link)造成板子颜色变暗或因烘烤不当变黄、变黑均不予以允收。但视情形可列 入次级品判定允收。

25．修补不良——修补线路未平贴基板或修补线路未作防焊处理，亦或有焊点残余松香未清理者。